第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者 om.cn)网站仔细阅读年度报告全文。 2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅年度报告"第三节管 理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 3本公司董事会、临事会及董事、临事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在

3年公司重事云、益事云及重事、益事、尚级官理人贞保证中長允 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 4公司全体董事出席董事会会议。

5天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

7董事会決议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基准向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本118.903,7288万股,以此计算合计拟派发现金

1800及水型工产170、10元(東土2013年12月31日,水中运水本110、300/2007)及、水电口 新口口 1800及水型 红利118,903、728.80元(合称)。2023年度经公司无进行资本公别金转增股本、不遂任股 公司2023年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议审议通 过,尚需提交公司股东大会审议。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用

第二节 公司基本情况

公司股票简况 √适用 □不适用

	公司股票简况		
股票种类 股票上市交易所及板	央 股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股 上海证券交易所科创	版 一 版中科技	688352	不适用

联系人和联系方式

□适用 √不适用

报告期公司主要业务简单 (一)主要业务、主要产品或服务情况

公司自设立以来,直从9年集成电路的先进封装和测试服务。公司秉持"以技术创新为核心驱动力"的研 公司自设立以来,直从9年集成电路的先进封装和测试服务。公司秉持"以技术创新为核心驱动力"的研 发理念,通过近二十年的研发积累和技术攻关,在凸块制造、测试以及后段封装环节上掌握了一系列具有自主 知识产权的核心技术和大量工艺经验,相关技术适用于显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等不同种 和607 次0.1796/1736/1747/1861日。2015年1月,至小38-2017(1975年2017),2015年1月,至小38-2017(1975年2017), 美的产品,可以满足客户高性化。高品质。百可靠性封装测试需求。 在集成电路凸块制造领域,公司以金凸块为起点相继研发出"微细间距金凸块高可靠性制造技术"、"大

尺寸高平坦化电镀技术"等核心技术,在提高预制图形高结合力,提升电镀环节稳定性等方面具有核心竞争力。近年来,公司的研发创新不局限于原有的金凸块上,在铜柱凸块、铜镍金凸块、锡凸块等其他凸块制造方面 也取得了行业领先的研发成果。以铜镍金凸块为例,公司县目前境内少数可大规模量产铜镍金凸块的企业,开 也以诗)17亚初元的可及成本。这种除亚二环为约,公司是自即规内少成马入死的国厂和除亚二环的正显,开发出了"张应力凸块"方金属民技术"、"新加重线圈不绕凸块制造技术"、"高介电层加工技术"等核心技术,可在较低成本下有效提升电源管理芯片等产品的性能。 在集成电路测试领域,公司具有以"测试核心配件设计技术"、"集成电路测试自动化系统"为代表的测

可测接合"、(TSDmm大版画圈晶封装"、(本方位高效研览热解决技术"、高高稳定性温颐研修切削"等关键技术。针对非显示类芯片的DPS封装工艺,公司研发出"高精高稳定性新型半导体材料温颐切削技术",在可 切割品圆的精度。厚度、材质等方面进行了创新、尤其县面对半导体材料种类的不断丰富。如钼酸锂 LiTaO3)、硅锗(SiGe)、铌酸锂(LiNbO3)等,公司皆有显著成果。

就集成电路封装测试行业而言,目前行业内主要存在IDM公司以及专业封装测试公司(OSAT)两类。基 于技术优势、7部产品、8户程体、产业能量等应素、相较于集芯片设计、制造、封制等多个产业性环节于一身的IDM模式、公司专注于集成电路产业链中的先进封装测试服务。报告期内、公司主要经营模式保持稳定, 另可出历例45.7、公司文正了解决。由于"业绩中的万匹封来的民族劳。依百州户"、公司工会会合物区域中经定。 未发生重大变化。影响公司经营模式的关键取累主要用于予业政策的变化或推进、市场资单特况变化 行业发 展趋势、前沿产品技术的发展与应用等。未来,公司将积极巩固现有业务优势,把握市场、技术等方面的发展前 瞻,实现市场竞争力的稳固与加强。

公司主要从事集成电路的先进封装测试。可为客户提供定制化的整体封测技术解决方案,处于半导体产 业链的中下游·作为专业的封装测试企业(OSAT)。公司产业成在市场的证外,通过不断经过源、处于干涉的工程的中下游·作为专业的封装测试企业(OSAT)。公司来开集成电路转接测试行业(OSAT)。公司在 设计公司(Fabless)委托届圆代工企业(Foundry)将制作完成的届圆运送至公司,公司按照与IC设计公司约 定的技术标准设计封测方案,并对晶圆进行凸块制造、测试和后段封装等工序,再交由客户指定的下游厂商以

完成终端产品的后续加工制造。公司主要通过提供封装与测试服务获取收入和利润。

(2)采购模式 公司设置采购部 统筹负责公司的采购事宜 根据实际生产需要 采购部按生产计划采购会款 靶材 光阳 该等原材料以及其他各类辅料,并负责对生产设备及配套零部件进行采购。针对部分价格波动较大且采购量 较大的原材料(如金盐等),在实际需求的基础之上,公司会根据大宗商品价格走势择机采购以控制采购成 本。由需求部门提出采购需求,经审核后产生清购单、采购部租后进行两价,比价和以价充程,通过完合选比后确定供应商并生成采购订单。供应商根据采购订单进行供货、采购部进行交明追踪及请款作业。公司建立了 《供应商管理办法》等供应商管理体系,每个季度定期对供应商进行考核,并对品质、交期和配合度三大指标

公司建立了一套完整的生产管理体系,由于封测企业需针对客户的不同产品安排定制化生产,因此公司 主要采用"以销定产"的生产模式。公司下设凸块测试中心、先进封装中心与品保本部负责生产与产品质量管

合肥颀中科技股份有限公司

公司生产流程主要包括首批试产、小批量量产和大批量生产三个阶段,具体如下: ①首批试产:各户提供芯片封装测试的初步工艺方案,公司组织技术及生产人员根据方案进行试产,完成

②小批量量产:首批试产后的样品经客户验证,如满足相关技术指标的要求且封装的产品符合市场需求,

则进入小批量量产阶段。此阶段,公司着重进行生产工艺、产品良率的提升。 ③大批量生产,在大批量生产阶段、生产计划部厂根据客户订单需求安排生产、展除生产进度并向客户提供生产进度报告。此阶段、公司需保障产品具有较高的可靠性和良率水平,并具备较强的交付能力。

(4)销售模式 公司下设行销中心,包括显示行销本部、非显示行销本部与客户服务部三大部门,并在中国台湾设立办事

外负责当地客户的开发和维护。公司销售环节均采用直销的模式。公司主要通过主动开发。客户引荐等方式获 公司主要采用自主研发模式,公司以市场和客户为导向,坚持突破创新,不断发展先进产品封测技术,并

设立专业的研发组织及完善的研发管理制度。公司研发流程主要包括立项、设计、工程试作、项目验收、成果转 化5个阶段。

(三)所处行业情况

(1) 所处行业

公司的主营业务为集成电路的封装测试,根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于计算机,通信和其他电子设备制造业(C39)。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017),公司属 于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)下属的集成电路制造业(C3973),具体细分行业为集成电路封

公司是集成电路高端先进封装测试服务商,可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务,覆盖显示驱 动芯片,电源管理芯片,射频前端芯片等多类产品。公司在比凸块制造(Bumping)和置届封装(FC)为核心的先进封装技术上积累了丰富经验并保持行业领先地位,是境内少数掌握多类凸块制造技术并实现规模化量 的集成电路封测厂商,也是境内最早专业从事8吋及12吋显示驱动芯片全制程(Tum-key)封测服务的企

(2)行业发展阶段及基本特点

集成电路封测是集成电路产品制造的后道工序,指将通过测试的晶圆按产品型号及功能需求加工得到独 立集成电路的过程,具体包含封装与测试两个主要环节。

集成电路封装是指将集成电路与引脚相连接以达到连接电信号的目的,并使用塑料、金属、陶瓷、玻璃等 材料制作外壳保护集成电路免受外枢环境的损伤,集成电路封装不仅起到集成电路芯片内键合点与外枢进行电气连接的作用,也为集成电路提供了一个稳定可靠的工作环境,使集成电路能够发挥正常的功能,并保证其 且有高稳定性和可靠性。

集成电路测试包括进入封装前的晶圆测试(${
m CP}$)以及封装完成后的成品测试(${
m FT}$),晶圆测试主要是在 晶圆层面上检验每个晶粒的电性,成品测试主要检验切割后产品的电性和功能,目的是在于将有结构缺陷以

及功能、性能不符合要求的芯片筛选出来。由于不同集成电路产品电性能、尺寸、应用场景等因素各不相同,因此造成封装形式多样复杂。根据是否 具有封装基板以及封装基板的材质,集成电路封装产品可以分为四大类,即陶瓷基板产品、引线框架基板产 品、有机基板产品和无基板产品,其中陶瓷基板产品,3级框架基板产品和有机基板产品都可以分为饲装封装和引线键合封装两种方式,而无基板产品又可具体分为扇出型封装(Fan-out)和扇人型晶圆级芯片尺寸封 装(Fan-in WLCSP)两类。

在业内,先进封装技术与传统封装技术主要以是否采用焊线(即引线焊接)来区分,传统封装一般利用引 线框架作为载体,采用引线键合互连的形式进行封装,即通过引出金属线实现芯片与外部电子元器件的电气 连接;而先进封装主要是采用倒装等键合互连的方式来实现电气连接



公司所处的先进封测行业,具有较高的技术门槛和难点,需要企业在技术创新、设备投入、人才培养和产 业链合作等方面进行持续的努力。①如金凸块制造环节具有溅酸,资光(光刻)、地刻、电镀等多道环节,需要在单片晶圆表面制作数百万个极其微小的金凸块作为芯片封装的引脚,并且对凸块制造的精度、可靠性、微细 间距均有较高的要求,因而目前中国大陆具备凸块制造能力的封测企业较少;②铜柱凸块、铜镍金凸块、锡凸 块制造环节都具有再纯化层制作、溅酸,黄光(光刻)多次电镀、蚀刻等多道环节。需要在单片温固表面数万颗芯片内实现多次电镀,微间距线圈环绕、高介电层隔离、多层堆叠等技术。以铜镍金凸块为例,芯片置铜比例 大,大面积的覆铜通常会产生较高的应力,对芯片产生破坏,而应力释放就需要从种子层的材料、厚度、工艺控 人,人们可知强则通为宏于之级问题。 相,以及晚化及防材料,厚度,设计等各方面进行控制,另外对于多次电镀高度的均匀性要求,微而建筑 度和间距的精准控制、多层结构各层间高度控制和层与层间的结合力都有着很高的要求;②先进封装芯片的 测试环节,需要具备全面的测试和验证流程,以确保芯片在各种工作条件下的性能和可靠性,这包括电气性能 測试、信号完整性測试、不同温度环境下的性能測试等,測试技术需要不断更新以适应新的应用领域及环境 随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的发展,先进封装测试技术的重要性将进一步凸显,成为推动半导体产 业发展的关键因素;(4在COP对装环节,由于显示驱动芯片1/0接点间距最小仅数擦米,需要在几一毫秒内同时将数千颗1/0接点一次性精准、稳定、高效地进行结合,难度较大,需要配备专门的技术团队进行持续研发。

不断提升。2023年,公司显示驱动芯片封测业务销售量1,391,087.36千颗,营业收入14.63亿元,是境内收入规 模最高的显示驱动芯片封测企业,在全球显示驱动芯片封测领域位列第三名。 在不断巩固显示驱动芯片封测领域优势地位的同时,公司逐渐将业务扩展至以电源管理芯片、射频前端

公司自设立以来即定位于集成电路的先进封装业务,子公司苏州颀中成立于2004年,是境内最早实现显

示驱动芯片全制程封测能力的企业之一,通过20年的李勤耕耘,公司乃经数个半导体行业周期,业务规模和技术水平不断壮大,在境内显示驱动芯片封测领域常年保持领先地位,同时在整个封测行业的知名度和影响力

芯片为主的非显示类芯片封测领域,持续延伸技术产品线,在新制程、新产品等领域不断发力,向价值健高端 拓展,积极扩充公司业务版图,向综合类集成电路先进封测厂商迈进。2023年,公司非显示类芯片封测营业收 Å 12 997 12万元 较丰年同期增长9 09% 多年来公司在产品质量、可靠性、专业服务等方面赢得了客户的高度认可,积累了联咏科技、敦泰电子、奇

景光电、奕斯伟计算、瑞鼎科技、谱瑞科技、晶门科技、集创北方、砂力杰、杰华特、南芯半导体等境内外优质客

2023年公司持续深化研发创新,巩固细分领域市场优势,稳步推进产能提升,子公司苏州颀中荣获"江苏 省企业技术省研发机构"等荣誉称号。

升芯片集成密度和芯片内连接性能已成为当今集成电路产业的新趋势。先进封装技术能够在再布线层间距、封装垂直高度、I/O密度、芯片内电流通过距离等方面提供更多解决方案。封装环节对于提升芯片整体性能愈 发重要,行业内先后出现了Bumping、FC、WLCSP、2.5D、3D等先进封装技术,先进封装已经成为后摩尔时代

随着5G通信技术、物联网、大数据、人工智能、视觉识别、新能源汽车、自动驾驶等新兴应用均 展,为集成电路产业发展带来巨大的机会,同时新兴应用市场对集成电路多样化和复杂程度的要求越来越高, 不成为现代生活,业及保证完全人们的证实,但可能人员还们证为公司现代生活之代码。这个社会是是不是是一个工程,有关键的是一个工程,是一个工程,不是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,就是一个工程,这一个工程,就是一个工程,就是一个工程,就是一个工程,这一个工程,就是一个工程,就是一个工程,就是一个工程,就是一个工程,就是一个工程,这一个工程,就是一个工程,这一个工程 场的需求变革为集成电路产业提供了巨大增长动力。同时得益于各大面板厂如京东方、维信诺、天马等对 AMOLED的持续布局,AMOLED渗透率不断增长。根据CINNO Research 数据显示,2023年全球市场 AMOLED智能手机面板出货量约6.9亿片,同比增加约16%,另根据Omdia预估,AMOLED智能手机的需求将 持续增长。同时随着其他应用的提升,AMOLED显示驱动芯片市场在2028年前将保持双位数的增长

近年来,随着中国大陆电子制造业快速发展,国家对集成电路产业重视程度不断提升,推出了一系列法规 和产业政策推动行业的发展,同时在税务、技术、人才等多方面提供了有利支持。

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本年比上年 增咸%)	2021年
总资产	7,153,333,609.63	4,823,070,377.17	48.31	4,420,198,205.49
归属于上市公司股东的净 资产	5,830,126,768.94	3,223,245,057.27	88.08	2,912,957,056.26
营业收入	1,629,340,035.50	1,317,063,145.81	23.71	1,320,341,424.00
归属于上市公司股东的净 利润	371,662,508.64	303,175,043.33	22.59	304,665,743.85
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	339,685,424.03	271,122,714.05	25.29	285,630,266.01
经营活动产生的现金流量 净额	541,275,168.61	701,403,791.26	-22.83	608,482,013.43
加权平均净资产收益率 (%)	7.59	9.88	减少2.29个百分点	11.17
基本每股收益(元/股)	0.33	0.31	6.45	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.31	6.45	0.31
研发投入占营业收入的比例(%)	6.52	7.59	减少1.07个百分点	6.68

3.2报告期分季度的主要会计数据

	(1-3月份)	第二字度 (4-6月份)	第二學度 (7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	308,474,908.60	380,333,369.54	458,399,926.18	482, 131, 831.18
归属于上市公司股东的净利润	30,612,641.92	91,609,123.58	122,737,345.94	126,703,397.20
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	27,178,380.99	75,263,894.22	113,505,435.65	123,737,713.17
经营活动产生的现金流量净额	43,366,868.76	89,844,592.89	194,734,508.32	213,329,198.64
,	季度数据与巴	披露定期报告数据	居差异说明	
□适用 √不适用				

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东

单位:股

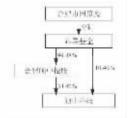
股东性质 股东名称 (全称)

存托凭证持有人情况 存代先近持有人情况 □适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用 1.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

沙特斯田原族

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情 况有重大影响和预计去来会有重大影响的事项 06有組元影·鸣和顶口木米芸有组八定·鸣的争项。 报告期内,公司实现竟业晚入162。98400万元,较上年间期增长23.71%;实现归属于上市公司股东的净利 润37.166.25万元,较上年同期增长22.59%;扣除非经常性损益后后归属于上市公司股东的净利润33.968.54万

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情

证券代码,688352

证券简称: 颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司

一届监事会第十五次会议决议公告

(下转B181版)

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 生,准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、

日		单位:元 币	种:人民币
项目	本报告期	本报告期比上年同期增減 幅度(%)	变动

.00 III	本报告期		本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入		443,405,252.67	43.74
归属于上市公司股东的净利润		76,687,049.55	150.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润		169.05	
经营活动产生的现金流量净额		139,325,879.74	221.27
基本每股收益(元/股)		0.06	100.00
稀释每股收益(元/股)		100.00	
加权平均净资产收益率(%)	1.31		增加0.37个百分点
研发投入合计	30,812,790.94		34.73
研发投入占营业收入的比例(%)		6.95	减少0.46个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)
总资产	7,116,133,403.64	7,153,333,609.63	-0.52
归属于上市公司股东的所有者权益	5,906,851,963.37 5,830,126,768.94		1.32

人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 房补助除外 2,462,09 1,221,9 区取消,修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公 介值变动产生的附益

山道用 V 不道用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因	
营业收入	43.74	市场需求回暖,销量增加所致。	
归属于上市公司股东的净利润	150.51		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	169.05	市场需求回暖,营收规模增加所致。	
经营活动产生的现金流量净额	221.27	市场需求回暖,提高营业收入,导致销售商品的现金流入增加。	
基本每股收益(元/股)	100.00	净利润随市场需求复苏,营收规模上升而增加所致。	
稀释每股收益(元/股)	100.00	/ 净利制随市场需求复办,宫收规模上升而增加折	
研发投入合计	34.73	主要系对技术、工艺等进行持续的开发投入所致。	

MISSISTALIA				34.73 土安州X	1524、1124年2017年	719KHYFT /5K1	义人归注义。
、股东信息 -)普通股股东总数和ā	表决权恢复	复的优先股股	东数量》	及前十名股东	持股情况表		单
报告期末普通股股东总数		20,207	报告期末初	表决权恢复的优先服	段股东总数(如有)		不适用
	i	前10名股东持股情	兄(不含通)	过转融通出借股份)		
	EG-6		4+m	Life of a star (DET All of All Obl.	包含转融通借出	质押、标记或冻结情况	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例(%)	持有有限售条件 股份數量	股份的限售股份 数量	股份 状态	数量
合肥颀中科技控股有限公司	国有法人	397, 127, 159	33.40	397, 127, 159	397, 127, 159	无	0
Chipmore Holding Company Limited	境外法人	302,389,708	25.43	302,389,708	302,389,708	无	0
合肥芯屏产业投资基金 (有限合伙)	其他	123,639,298	10.40	123,639,298	123,639,298	无	0
CTC Investment Company Limited	境外法人	34,398,078	2.89	34,398,078	34,398,078	无	0
南京盈志创业投资合伙企业 (有限合伙)(曾用名:合肥 奕斯众志科技合伙企业(有 限合伙))	其他	32,143,301	270	32,143,301	32,143,301	无	0
徐瑛	境内自然人	18,367,834	1.54	18,367,834	18,367,834	无	0
北京芯动能投资基金 (有限 合伙)	其他	17,835,281	1.50	17,835,281	17,835,281	无	0
中信建投基金 – 招商银行 – 中信建投基金 – 颀中科技员 工参与战略配售集合资产管 理计划	其他	9,923,966	0.83	9,923,966	9,923,966	无	0
中国国有企业混合所有制改 革基金有限公司	国有法人	9,090,909	0.76	9,090,909	9,090,909	无	0
国寿安保基金 - 中国人寿保险股份有限公司 - 分红险 - 国寿安保基金国寿股份均衡 股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	8,415,413	0.71	0	0	无	0
		前10名无限	貝售条件股 差	东持股情况			
股东名称		持有无限負	5名仕志诵8	5的数量	股份和	中类及数量	
BEAVERY		1TH JUNKE	12K11 (NL)(12)(1	XHJSAIIL	股份种类		数量
国寿安保基金 - 中国人寿保隆	企股份有限						

8,415,413

人民币普通股

人民币普通股

8.415.413

7,009,345

3,438,062

合肥颀中科技股份有限公司

中国建设银行股份有限公司 – 南方高 新蓝筹混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 – 南方皇 前瞻混合型证券投资基金 人民币普通股

25%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业条用借股份情况

→ 內共 地定 随 尹 坝需提 履 投 资 者 关 注 的 关 于 公 司 报 告 期 经 营 情 况 的 其 他 重 要 信 息□ 适 用 √ 不 适 用皿 季 座 时 冬 坦 本 坦 本 坦 本

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
充动资产 :		
货币资金	1,826,573,159.78	2,142,593,988.57
告算备付金		
斥出资金		
交易性金融资产	130,242,191.78	144,021,461.92
行生金融资产		
应收票据		
应收账款	163,481,471.98	168,225,129.65
应收款项融资		
预付款项	33,089,784.28	4,877,799.34
应收保费		
立收分保账款		
立收分保合同准备金		
其他应收款	4,756,799.66	48,959,788.94
其中:应收利息		
立收股利		
买人返售金融资产		
字货	404,781,300.80	408,214,173.66
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,457,863.66	69,190,661.32
 充动资产合计	2,638,382,571.94	2,986,083,003.40
非流动资产:		
		
资权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,800,624,998.67	2,520,150,754.85
在建工程	434,169,271.33	565,272,472.22
生产性生物资产	101,100,1111,100	0,00,010,17000
由气资产		
世田权 资 产	377,596.78	613.835.69
无形资产	165,225,359.30	165,964,020.11
其中:数据资源	100,220,000,00	100,304,020.11
F发支出		
其中:数据资源		
存誉	070 TOO 077140	OND TWO OFFIAG
研営 长期待練费用	872,738,377.16	872,738,377.16
	2,046,848.77	1,506,713.71
並延所得税资产 	26,333,953.15	25,047,492.26
其他非流动资产	176,234,426.54	15,956,940.23
非流动资产合计	4,477,750,831.70	4,167,250,606.23
资产总计	7,116,133,403.64	7,153,333,609.63
充动负债:	1	
短期借款	86,591,003.36	121,023,498.27
句中央银行借款		
斥人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
拉付票据		
拉付账款	642,809,675.79	492,673,101.82
页收款项		
合同负债	26,453,238.52	30,503,495.85
去出回购金融资产款		
及收存款及同业存放		
弋理买卖证券款		
代理承销证券款		
立付职工薪酬	40,156,644.33	65,144,798.91
立交税费	4,373,164.11	14,390,570.44
其他应付款	2,227,172.91	25,642,015.58
其中:应付利息	argamer, a radiot	20,020,01000
PE 1 + ISS 13 (13/IS)	1	

流动负债合计	884,508,635.29	974,355,587
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	285,439,032.14	309,189,032
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	111,819.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,221,953.77	39,662,221
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,772,804.98	348,851,253
负债合计	1,209,281,440.27	1,323,206,840
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,189,037,288.00	1,189,037,288
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,495,738,875.58	3,495,738,875
减:库存股		
其他综合收益	2,355,102.77	2,316,957
专项储备		
盈余公积	15,296,452.25	15,296,452
一般风险准备		
未分配利润	1,204,424,244.77	1,127,737,198
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,906,851,963.37	5,830,126,768
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,906,851,963.37	5,830,126,768
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,116,133,403.64	7,153,333,609

编制单位:合肥颀中科技股份有限公司

读经营净利润(净亏损以"-"号填列

(二)按所有权归属分类

68.94 09.63 曼媛 2024年第一季度 2023年第一季度 443,405,252.6 308,474,908.60

其中:营业收入 利息收入 戸膳保券 其中:营业成本 220,588,308.7 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 R单红利支出 税金及附加 4,817,183.5 1,586,294.84 销售费用 1,581,708.9 1,843,315.9 19,855,824.4 研发费用 30.812.790.9 22,870,319 其中:利息费用 4,648,098.2 9,688,191 11:其他收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 争敞口套期收益(损失以"-"号填列 -898,783.0 -254,144.94 -365,685.95 资产处置收益(损失以"-"号填列) 33.401.362.14 加:营业外收入 1.015.331.5 931.842 241,411 34,091,792 89,227,983.0

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	76,687,049.55	30,612,641.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	38,144.88	-224,520.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,144.88	-224,520.66
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	38,144.88	-224,520.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外市財务报表折算差額	38,144.88	-224,520.66
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	76,725,194.43	30,388,121.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	76,725,194.43	30,388,121.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03

编制单位:合肥颀中科技股份有限公司

	早位:兀	中种:人民中 申订失型:木
項目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	544,674,792.05	350,902,153.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款争增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,452,255.57	764,171.79
收到其他与经营活动有关的现金	21,804,405.25	6,331,815.43
经营活动现金流入小计	567,931,452.87	357,998,140.54
购买商品、接受劳务支付的现金	237,111,507.49	179,280,926.98
客户贷款及垫款争增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	118,313,969.85	96,274,353.92
支付的各项税费	52,455,607.56	21,611,688.63
支付其他与经营活动有关的现金	20,724,488.23	17,464,302.25
经营活动现金流出小计	428,605,573.13	314,631,271.78
经营活动产生的现金流量净额	139,325,879.74	43,366,868.76
二、投资活动产生的现金流量:		<u>L</u>
收回投资收到的现金	428,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,001,193.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	1,356,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	430,357,193.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,098,796.56	120,019,418.71
投资支付的现金	414,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	665,098,796.56	120,019,418.71
投资活动产生的现金流量净额	-234,741,60259	-120,019,418.71

公司负责人: 杨宗昭 王曾会计工作负责人: 余成強 会计机构负 2024年起前次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 回遇用 《不通用 特此公告

2,142,593,988.

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

30,612,641.92

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

合肥颀中科技股份有限公司董事会 2024年4月18日

135,140,235.7

10,785,175.4